



# 電子系實務專題研究製作注意事項

- 請依本系「實務專題選題作業」之規定，選定指導老師。
- 分組確定後，每組學員應定期向指導老師報到，實際次數由各指導老師決定。
- 專題研究報告之報告封面格式如表二所示，書寫格式如表三至表六所列，請注意其封面及內頁第一頁之書寫內容。
- 各次報告書繕打完成後，請老師閱審並於封面頁簽名，將簽名的封面頁掃描，附在檔案第一頁，再將報告轉成 **PDF** 上傳至 [moodle](#) 或 email 至 [huang1208@mail.ntust.edu.tw](mailto:huang1208@mail.ntust.edu.tw)，據以評定學期成績。(不必再印製紙本報告)
- 報告請遵照「專題研究報告編排格式」撰寫。
- 報告繳交時程：
  - (1) 修習三上/三下：  
(僅不分系及成績優異符合提前畢業資格者，可提前一學期修習)
    1. 計畫書(三上)：期中考後(11/30 前) 繳交。
    2. 期中進度報告(三上)：期末考前(1/15 前) 繳交。
    3. 期末總報告(三下)：期末考前(6/15 前) 繳交。
  - (2) 修習三下/四上：
    1. 計畫書(三下)：期中考前(4/15 前) 繳交。
    2. 期中進度報告(三下)：期末考前(6/15 前) 繳交。
    3. 期末總報告(四上)：期末考前(1/15 前) 繳交。
- 本系另訂有『國立臺灣科技大學電子工程系專題生評分辦法』及『國立臺灣科技大學電子工程系最佳專題評選辦法』，請於本系網頁學生須知查詢。(條文中有規定：本系修習實務專題同學，一律參與本系舉辦之成果展，缺席者將無法完成畢業手續。)

## 專題研究進度表

### 修習期間：三上/三下

(僅不分系及成績優異符合提前畢業資格者，可提前一學期修習)

修習學期	3上 (必修)	3下 (必修)	暑假	4上
時間 進度 項目	.9.10.11.12.1.	.2.3.4.5.6.	.7.8.9.	.9.10.11.12.1.
選定老師	■			
訂定題目	■			
繳計畫書		■		
繳期中報告		■		
專題成果展				■
繳期末總報告				■

### 修習期間：三下/四上

修習學期	3上	3下 (必修)	暑假	4上 (必修)	4下
時間 進度 項目	9.10.11.12.1.	.2.3.4.5.6.	.7.8.9.	.9.10.11.12.1.	.2.3.4.5.6.
公佈題目	■				
選題	■				
繳計畫書		■			
繳期中報告		■			
專題成果展				■	
繳期末總報告				■	

# 專題研究報告編排格式

一、專題研究報告分三類：

1. 專題研究計劃書 (proposal)
2. 專題研究期中進度報告
3. 專題研究期末總報告 (Final Report)

二、專題研究計劃書：封面格式，如表二所示。

內容格式首頁，如表三所示。

內容格式第二頁起，如表四所示。

三、專題研究期中進度報告：封面及內容首頁格式，分別如表二、表三所示。

內容格式第二頁起，如表五所示。

四、專題研究總報告：封面及內容首頁格式，分別如表二、表三所示。

內容格式第二頁起，如表六所示。

表二：封面格式

國立台灣科技大學電子工程系

學年度第 學期實務專題

計畫書 or 進度報告 or 總報告

專題題目

組 別： \_\_\_\_\_

(請務必填寫，公告於系網“歷屆專題”項下)

組 員： 姓名： \_\_\_\_\_ 學號： \_\_\_\_\_

姓名： \_\_\_\_\_ 學號： \_\_\_\_\_

指導老師： \_\_\_\_\_

中華民國 年 月 日

表三：各次報告書之第二頁(封面格式如表二)

題 目：\_\_\_\_\_

組員姓名及學號：\_\_\_\_\_

組 別：\_\_\_\_\_

指 導 老 師：\_\_\_\_\_

一、摘 要：

計 劃 書：(簡述本專題的目的、進行的方法及預期成果)

進 度 報 告：(簡述本專題的目的、進行的方法及預期成果，及目前已完成之  
工作項目)

總 報 告：(簡述本專題的目的、進行的方法及預期成果，完成的成果)

註：“摘要”以精簡為原則，儘量不要超過一頁。

#### 表四：專題報告計劃書內容格式 (第 2 頁起)

- 一、 摘要：(簡述本專題的目的、進行的方法，及預期成果)  
首頁
- 二、 動機：(為何選此專題,在工業應用上有何重要性?)  
第二頁起
- 三、 研究方法：(如何以過去及目前所學習得的訓練來完成本專題，列出本專題所逐步採用的方法，並加以說明原因)
- 四、 預期成果：(定出本專題所欲設計系統的規格[specification]，如以”邏輯分析卡的製作”專題為例，應可列出：
  - (1) 本專題的特點：和傳統邏輯分析儀相比較，說明其相同、相異點。
  - (2) 本專題的硬體規格，邏輯分析卡的取樣頻率(sample rate)為何？觸發(trigger)能為何？
  - (3) 本專題的軟體規格：配合的驅動程式(driver)功能為何？特殊演算法為何？...
  - (4) 其他規格.....
- 五、 時間進度表(列出未來一年的工作進度，以甘氏圖為之，參考附件一)
- 六、 工作分配(例出參加組員的工作分配項目)
- 七、 使用儀器及材料預估(如附件二、三各列表說明)
- 八、 參考資料(按照中國工程學刊之格式書寫，如附件四)

## 表五：專題研究進度報告

一、 摘要(見表三所列)

二、 簡介

分段說明本專題研究的目的,列出欲完成本專題所定規格,及至目前為止已完成那些項目

三、 研究方法

就所進行的專題說明採用研究方法,並可包含下列任一項或全部:(試分段或分小節加以敘述)

1. 理論模式的建立

2. 硬體製作

3. 軟體發展

4. 其他

四、 討論

討論目前已完成之工作項目,與計劃書所列預期成果比較,尚有那些項目待完成,研究將遭遇何種困難,預期如何克服?

五、 時間進度表

以甘氏圖為之(參考附件一),並以不同色筆區分目前工作進度與原先預估進度。

六、 參考資料

見附件四.

## 表六：專題研究總報告內容格式

### 一、摘要(見表三所列)

### 二、簡介

分段說明本專題研究的目的,簡介中應列出所欲設計系統的規格(specifications)。如邏輯分析卡的製作專題為例,應可列出:

- (1) 本專題的特點:和傳統邏輯分析儀相比較,說明其相同、相異點。
- (2) 本專題的硬體規格、邏輯分析卡的取樣頻率(sample rate)為何?觸發能為何?
- (3) 本專題的軟體規格:配合的驅動程式(driver)功能為何?特殊演算法為何?...
- (4) 其他規格...

並綜合說明採用的研究方法、進行方法,及所完成的研究成果為何?

### 三、理論 或 使用方法

說明完成本專題所需的理論模式,分析與設計的方法及步驟,文中的方程式、圖、表等均需編號。

### 四、實驗 或 範例

本節包含:

1. 硬體製作:線路的製作、繪圖、實驗波形等。
2. 軟體發展:軟體程式的流程圖、Documentation 等。
3. 實測結果。
4. 其他相關資料。

### 五、討論

討論應列出所設計完成的系統性能(performance)如何?此應對照簡介中所列規格逐項比較。說明差別的原因提出改進的方法以供下屆同學參考。

### 六、結論

結論應根據三、四、五節內容作一扼要總結,若對本專題未來的發展有所建議,亦應列出。

### 七、參考資料

參考資料之中、英文書寫格式如所附,請遵照此格式書寫(參考附件四)。

### 八、附錄

針對研究所發展出的系統,編寫使用手冊,以供後屆同學參考使用。







## 附件四：

### 參考文獻

所有參考文獻須按其在文中出現之先後，隨文註號碼於圓括號內，並依序完整列於文末。

### 例如:1)期刊

社文謙,「水滴在強制對流中之熱及質量傳遞」,中國工程學刊,第一卷,第一期,第 23-25 頁。(1989)

### 2)書籍

王文鈞、石延平、陳陵援,化學,第 85-98 頁,台北,正中書局(1976)。

英文文獻之寫法,請參閱下列實例：

### 1.Journals

Morris, J.G. and K.K. Howard, “Thermomechanical Treatments of Alloys,” J. Appl. Physics, Vol. 42, No. 1, pp.320-325 (1971).

### 2.Books

Ethin, B., Dynamics of Atmosphere Flight, John Wiley and Sons, New York, pp. 166-188(1971).

### 3.Conterence

Pfaltz, J. L. and A. Rosenfeld, “TITLL,” Proc. Of First international joint Conference on Artificial intelligence, Washington, D. C. (1969).

### 4.Report, Thesis, etc.

(1) Chu, S and C. S. Wang. “TITLE,” CSITR-66B-77, Chung Shan Institute of Science and Technology, Lungtan, Taiwan (1977).

(2) Hsio, C. H., “TITLE,” Dr. Engr. Thesis, Department of Electrical Engineering, National Cheng Kung University, Tainan, Taiwan, R.O.C.(1974).